

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

## 有研粉末新材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

(2023年12月)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	民生证券、信达澳亚基金、中信证券、嘉实基金	
会议时间	2023年12月6日 13:30-14:30 2023年12月6日 15:00-16:00	
会议地点	公司会议室	
上市公司接待人员	总法律顾问、财务总监：姜珊 证券事务专员：王琪	
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：公司介绍 A1：有研粉材控股股东中国有研科技集团是国务院国资委所属中央一级企业，有研粉材属于二级中央企业，主要的产品分为三大板块，包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印用粉体材料。铜基金属粉体材料主要应用于粉末冶金零部件、超硬工具、摩擦材料等领域；锡基焊粉材料主要应用于微电子封装和组装，针对电子元器件、半导体方面的封装焊接，并同步向下游锡膏等电子浆料方向发展。增材制造成型技术，是以计算机三维设计模型为蓝本，通过软件分层离散和数控成形系统，采用逐层叠加材料的方式，直接制造与相应数字模型完全一致的三维物理实体模型的制造方法。增材制造技术能够实现高性	

能复杂结构零件的无模具、快速、全致密近净成形，成材率可以达到百分之百。随着增材制造技术的应用广度和深度在不断扩展和延伸，公司立足于增材制造高端材料的重大需求，持续推进如铝合金粉、高温合金粉等 3D 打印用粉体材料的研发、生产与销售。公司基地分布在北京、合肥、重庆、山东、英国、泰国等地，其中重庆基地和泰国基地涉及募投项目，重庆基地募投项目已完成建设并正式投产，产能扩展 4000 吨；泰国基地募投项目预计 2024 年 6 月完成建设并投产，铜粉产能增加 5000 吨，主要面向欧洲、亚太等国际市场。

Q2: 请介绍一下公司增材制造板块的情况及后续规划？

A2: 增材制造板块是公司近几年重点关注和投入的新业务领域，目前公司主要在增材制造金属粉体材料方面开展工作，在增材制造产业链中属于上游粉体制造端。公司的球形粉体制备技术在锡基合金焊粉、铜基金属粉末、金属软磁粉末等产品制备上得到广泛应用，该技术于 2017 年被评为国家科技进步二等奖。基于公司技术和产业的优势，在增材制造领域的前期布局的基础上，公司于 2021 年底成立了有研增材，主营业务包括增材制造系列金属粉末产品的研究开发、生产、销售与服务以及高温合金、铜合金、不锈钢等高性能特种粉体产品的研究开发、生产、销售与服务，产品方面增材制造主要包括铝合金粉体、钛合金粉体、高温合金粉体和铜合金粉体四类产品，特种粉体包括软磁粉末、MIM 粉末、钎焊合金粉等产品，产品在市场上具有一定特色。在公司的募投项目中有科技创新中心建设项目，公司计划通过该项目向增材制造领域加大投入规模，建设增材制造数字产业中心，探索发展 3D 打印业务。

Q3: 3D 打印在民品方面的应用会不会有爆发力？

A3: 原先市场认为 3D 打印只适合多品种、小批量，但是其快速原型、近净成型等优势，特别是对复杂结构零件快速制造能力，能够替代一部分传统制造技术。随着技术的不断突破，增材制造技术的应用已从简单的概念模型、功能型原型制作向功能部件直接制造方向发展，并在造型评审、设计验证、复杂结构零件、多材料复合零件、轻量化结构零件、定制专用工装、表面修复、个性换装件等方面得到广泛应用。相信未来在民品市场还是非常有发展潜力的。

Q4: 铜基板块和锡基板块的下游应用有哪些？

A4: 铜基板块产品主要应用在粉末冶金零部件、电碳制品、摩擦材料、超硬工具等领域，公司逐步增加催化剂等

领域的应用；锡基板块产品主要应用微电子封装和组装，针对电子元器件、半导体方面的封装焊接等。

Q5：公司竞争力如何？

A5：公司从底蕴、地位、技术水平等方面都有独特的竞争优势，从技术出发，同类产品都能研发、生产，但研究背景出身人员对产品的产业化发展、市场开发能力相对薄弱一些，未来我们利用公司整体的市场占有率，发挥规模效应，加快新产品规模化、市场化的速度，提升公司盈利能力。

Q6：铜基板块市场空间多大，以及未来的竞争格局如何？

A6：公司产品新的应用、新的领域在不断增加，市场潜力大。目前国内纯铜粉市场五万吨左右，国际十几万吨，公司产品在国内占有率高，达 30%以上。未来铜基板块将朝着规模化、差异化方向发展。

Q7：公司锡基产品的竞争优势？

A7：锡基板块产品在中国市场占有率 20%左右。公司研发能力强，产品研发迭代速度优于竞争对手。

Q8：公司 3D 打印产品的竞争优势？

A8：公司增材板块产品有独占性，走差异化发展模式，做别人做不了的产品，在市场竞争中有独特优势。

Q9：公司增材制造用粉体材料的竞争优势？

A9：增材制造下游客户对金属粉体的需求差异性较大，但是对金属粉体的核心要求是粉体球形度好、空心球少，另外对粉体成材率、粒度分布、杂质含量及表面洁净度也有较高要求。公司粉末制备技术经过多年积累，产品品级和质量均具备竞争优势。公司的材料研发团队还可以参与到客户的设计端，共同设计、开发需要的粉体材料，做适合于增材制造工艺的粉体产品，共同解决客户的问题。

Q10：公司发展规划如何？

A10：公司制定了十四五规划，按照三个产品领域同步发展，分别为铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和增材制造粉体材料，铜基粉体材料板块目标是通过募投项目的落地扩大规模，达到 40000 吨产销量；锡基焊粉材料板块致力于技术迭代，并向下游新兴产业链延伸，同时调整产业结构，生产附加值更高的产品，达到 20%-30%的年增长率。其中电子浆料的应用领域，由消费电子、Led、半导体封装等，扩展到光伏等行业。增材制造板块加快放

量，在公司产业内占到三分之一利润规模。

Q11: 做设备的公司如果也进入粉体制备，和公司的关系会如何？

A11: 增材制造的核心技术在于粉体，粉体材料性能很大程度上决定最终产品的性能和质量。各公司产品方向和特点不一样，有各自的优势和劣势。公司研发团队在增材制造用球形金属粉体制备技术方面较早开展工作，同时作为有研科技集团所属团队，在新材料开发、低成本、高品质制备增材制造用金属粉体方面具有较多的经验和技術积累，有较强的市场竞争力。随着行业的发展，粉体制造和产品制造可能相互延伸，存在有一体化的发展趋势。公司目前主要以生产粉体为主，同时为往下游发展做好铺垫，不排除进一步发展的可能性。

Q12: 国资是否对公司有市值方面的考核？

A12: 暂时没有这方面的考核，但公司目标就是把企业做实做强，提高公司质量，回馈投资人。

Q13: 3D 打印优势和未来展望？

A13: 相比传统行业，3D 打印成型方式目前在汽车制造、航空航天、生物医疗等领域得到广泛应用。3D 打印技术可满足航空航天、武器装备、汽车零部件轻量化、一体化、拓扑优化设计和加工要求，随着 3D 打印应用领域的扩展，设备和材料成本的降低，以及批量打印的技术不断突破，未来可能会带来爆发式增长。

Q14: 电子浆料板块目前产能及扩产计划？

A14: 目前产能为 300 吨，预计明年达到 700 吨左右。在公司的募投项目中有科技创新中心建设项目，公司计划通过该项目向该领域加大投入。

Q15: 唯特偶是公司客户吗？

A15: 是公司全资子公司康普锡威的客户。

Q16: 原材料的波动对公司利润影响是否比较大？

A16: 目前而言影响不大，公司主要采用“原材料+加工费”的定价模式，且对存货做了套期保值，原材料波动主要影响公司营业收入。

Q17: 是否考虑做员工激励计划等？

A17: 因公司在 2019 年按照《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》，制定、实施了股权激励方案，目前该方

	案还在锁定期，解锁后会继续开展相关激励措施。
附件清单（如有）	
日期	2023年12月29日